

承接CPU芯片拆卸，除锡，植球加工

产品名称	承接CPU芯片拆卸，除锡，植球加工
公司名称	深圳市卓汇芯科技有限公司
价格	12.00/个
规格参数	加工方式:来料加工 工艺:提供有铅、无铅 加工设备:回流焊，返修台，加热台，植球台等
公司地址	深圳市宝安区西乡街道桃源社区广深路西乡段300号齐粤印机大厦2层A
联系电话	0755-36979941 15220066551

产品详情

批量承接BGA、DDR、EMMC、CPU、QFN、QFP、SOP、TSOP、SOJ、SOT等芯片拆卸、除胶、除锡、镀锡、清洗、植球、镀脚、整脚、去氧化、盖磨面、打字服务。

包装方式：编带、托盘、料管、抽真空等